無電解 Ni めっきした WC 粉末を用いて作製した

WC-Ni 系超硬合金の乾式摩耗特性

倉本英哲 隠岐貴史 松木一弘* 柳沢 平*

無電解 Ni(ニッケル)メッキを施した WC(炭化タングステン)粉末を用いて、Ni 相をバインダーとする WC - Ni 超硬合金を放電焼結法によって作製し、その乾式摩耗特性について調査を行った。なお、本研究ではめっき中の残存 P(リン)量を制御して、Pの及ぼす影響についても調査を行った。2 種類の無電解 Ni めっき中の残存 P量は約 5%と約 13%であり、それぞれ L.Pタイプおよび H.P タイプと呼ぶこととした。結果は以下のように要約される。

焼結は、均質で高密度の試料を得るために液相での焼結を選択したが、L.Pタイプで1273K、 H.Pタイプで1153Kと非常に低温での焼結温度で真密度化することができた。得られた試料の 比摩耗量は、一般に市販されている WC-7.8wt%Co 粉末を用いて作製した超硬合金と比較して 優れるものであった。また、Ni バインダー相の P 量は大きくなるほど、比摩耗量が大きくな ることが分かった。

キーワード:WC-Ni系超硬合金、無電解ニッケルめっき、放電焼結、比摩耗量

1 緒言

周期表 IVa~VIa 族に属する9種類の金属の炭化 物粉末を鉄,コバルト,ニッケルなどの鉄族金属を用 いて焼結結合した金属を総称して超硬合金という。超 硬合金は常温において非常に高い硬さを示し、特に耐 磨耗性に優れる。現在使用されている超硬合金の中で、 有名なものとして WC-Co 系超硬合金がある。これは、 結合相をコバルトとした炭化タングステン系の焼結体 である。機械的性質をはじめとする、様々の性質につ いて、Coが優れることは周知の事実であるが、価格や 産出量が不安定などの理由によって、結合相を Ni や Fe などに代替する試みが多くの研究者によって行わ れている⁽¹⁾⁻⁽⁸⁾。特に、WC-Ni 系超硬合金は耐食性や 接合性が、WC-Co 超硬合金よりも優れるとの報告⁽⁸⁾ もあり、Co の代替として期待されている。

超硬合金は、原料粉末を適当に混合し、これを真空 焼結等によって焼結することで作製されるのが一般的 である。例えば、WC-Ni系超硬合金では、目指す組成 に合わせてWCとNiを斤量して混合し、これを真空 焼結する。このとき、Ni粉末の粒径や粉末の混合状態 によっては、WC 粒子同士の接触部において、埋めら れることのない空隙が存在する可能性が高くなる。こ の空隙は破壊の起点となり、靭性やその他の機械的性 質を著しく減じることとなることが考えられる。そこ で筆者らは、上述のような空隙の存在を少なくするこ とを第一の目的として、試料作製に供する WC 粉末に Ni めっきを施すことを提案する。これによれば、WC 粒子同士の接触はなくなり、粉末同士の接触部は必ず Niとなる。焼結法としては、低温短時間での焼結が可 能⁽⁹⁾であり、また、セラミックスをはじめとする難焼 結材料の焼結に実績の高い^{(3)-(5),(10)-(12)}放電焼結法を用 いることとした。放電焼結法は、通電焼結法であり、 今回の Ni めっきした原料粉末を用いる手法は、圧粉 体への通電性も期待することができる製造プロセスで ある。なお、本研究では、めっきに無電解 Ni めっき を用いた。これは、粉末すべてに均一にめっきを行な うことができ、膜厚等めっきに関わる特性の制御が比 較的容易なためである。

本研究では、上述の手法によって WC-Ni 系超硬合 金を作製して摩耗試験を行い、その製造プロセスおよ

*広島大学大学院工学研究科

び摩耗特性について評価することとした。

2 実験方法

2.1 試料作製

WC 粉末は、アライドマテリアル製(WC60S)の純度 99.9%で平均粒径が 6.4µm のものを用いた。この粉末 の走査型電子顕微鏡(SEM)像を Fig.1 に示す。



Fig. 1 SEM images of as-received WC powder.

無電解 Ni めっきは、電気めっきとは異なり、厚さの 偏りが少なく、対象に均一にめっきすることが可能で ある。しかし、施しためっきには還元剤としてのPが 残存することが知られている。この残存した Pが、作 製した試料の諸特性に対して影響を及ぼすことが考え られ、この影響を明らかにするために、本研究では残 存 P 量が異なる Ni めっきが可能な 2 種類のめっき浴 を用意した。一つはめっき浴中の P 量が 1~2%に制 御されたもの(㈱奥野製薬製 TOP NICORON LPH) で、もう一つは 12~13%に制御されたもの(㈱奥野製 薬製 TOP NICORON SA-98)である。以降本報告では、 これらのめっき浴でめっきした粉末とこの粉末を用い て作製した試料を、それぞれ L.P(低リン)および H.P(高リン)タイプと呼ぶこととする。めっき浴の建浴 は毎処理ごとに行い、その濃度と粉末量を制御して、 めっきは飽和するまで行うことで、そのめっきの再現 性を確保することとした。なお、最終的にはめっきの 膜厚を 0.2~0.3µm となるようにした。出来上がった 粉末の蛍光X線分析を行った結果、そのめっき量とし ては約 20wt%となることが分かり、これは、粉末の 粒径を考慮して、めっき膜厚から算出した Ni めっき 量とほぼ一致することが分かった。理論的にWC 粒子 径が一定として、最密構造をとったとして、その相対

密度は 0.74 である。このとき、20wt%の Ni 量であれ ば、理論上その体積比は約 50vol%にもなり、十分に 空隙を埋めることができると考えられる。L.P および H.P タイプの Ni めっきを施した WC 粉末の断面の SEM 観察結果を Fig.2 に示す。



Fig. 2 SEM images of (a)H.P and (b)L.P type electroless Ni plated WC powder.

そのどちらも均質で 0.2~0.3μm のめっき相が形成さ れていることが確認される。なお、実際の Ni めっき 中の残存 P 量は、蛍光 X 線分析を行った結果、それぞ れ約 5%および 13%であった。

上述の2種類のL.P、H.Pタイプの粉末およびWC 粉末と20wt%のNi粉末を混合したものをそれぞれ秤 量し、放電焼結法によって円柱状(ø 10mm×20mm) の焼結体を作製し、その縦方向中心部で切断、研削を 行い、この研削面を試験面とする試験片を作製した。 放電焼結条件については、粉末粒子間の酸化膜の絶縁 破壊などによる圧粉体比抵抗の減少を目的とした予備 焼結として、焼結圧力が 15MPa、on/off 時間がそれぞ れ 100ms、パルス電流が 100A の矩形波直流パルス通 電を900s行い、その後、焼結圧力を40MPaに上げて、 連続パルス通電による緻密化を行った。連続パルス通 電過程における制御については、温度で行うようにし、 液相状態での焼結を行うこととした。例えば、純 Ni の融点は、1725Kであり、この場合、加圧しながら温 度を上げていき、1725K 直下で 600s 間温度保持する ようにした。なお、比較対象として WC 粉末と 20wt% の純 Ni 粉末の混合粉も準備したが、これは P が 0% の場合を想定した。用いたNi粉末はその粒径が0.8µm の微粉であり、この粉末を用いることで、試料作製時 の組織の不均一性を少なくすることとした。以降、こ の混合粉を用いて作製した試料をBlendタイプと呼ぶ。

2.2 硬さおよび摩耗試験

試験は硬さ試験および摩耗試験を行った。

硬さ試験はJISに規定するロックウェル硬さ試験の Aスケールで行った。

摩耗試験方法は、代表的なリングオンディスク方式 の摩耗試験機である大越式摩耗試験機を用いて行った。 大越式摩耗試験は回転円盤(SUJ2 製)を平板試験片に 押し付けて摩耗させる摩耗試験である。なお、回転円 盤は焼き入れ焼き戻し処理を行ったものと熱処理を行 わず、鋼棒より切り出したままのもの(焼きなまし材) の2種類を使用した。その硬度はそれぞれロックウェ ル C スケール硬さで HRC63 (HRA83 相当)および HRC10 相当である。この摩耗試験機と試験方法の概 略図を Fig.3 に示す。



Fig.3 Schematic drawing of wear test method.

本研究では、リングを平板試験片に押し付ける荷重を 一定とした一定荷重条件での試験とし、このときの押 し付け荷重(F)は196Nを選択した。この摩耗試験にお いては、試験終了後の摩耗痕幅(b)の測定を行うことで、 摩耗量(W)を以下の幾何学的近似式によって算出する ことができる。摩耗速度は1.58m/sを選択し、試験片 に関わらず一定とした。

$$W = \frac{Bb^3}{12r}$$
(1)

ここで、r および B は、それぞれ回転円盤の半径(mm) および回転円盤の厚さ(mm)である。本研究において、

r=15、B=3.0 である。

次に、摩擦係数(µ)に関しては、回転円盤の軸トルク (T)が分かれば、一般的な摩擦係数を求める以下の式に よって表すことができる。

$$\mu = \frac{T}{Fr} \tag{2}$$

なお、試験はすべて乾式で行うこととした。

3 実験結果および考察

3.1 焼結過程

Fig.4にL.PおよびH.Pタイプで焼結を行ったときの緻密化過程における温度と相対密度の関係を示す。



Fig.4 Relation between compact temperature and relative density during spark sintering by using (a)L.P and (b)H.P type electroless Ni plated powder.

本研究の試料作製における焼結は、その組織の安定性 を目指して、液相での焼結を行うこととしたが、バイ ンダーである Ni が液相になるとき、その焼結温度は 上昇しなくなり、相対密度は限りなく1に近づく。こ の現象の起こる温度が H.P タイプで1153K、L.P タイ プで1273K であった。なお、純 Ni の融点は1726K であり、実際 Blend タイプでは、液相焼結で真密度化 するには、約 1673K~1723K の焼結温度が必要であ った。また、WC - Co についても、Co の融点が1768K であることを考慮して、その焼結温度は純 Ni 粉末を 用いた場合とほぼ同様となることが想定される。今回、 市販の WC - 7.8wt%Co 合金粉末を用いて試料を準備 したが、その焼結温度は Blend タイプとほぼ同様であ った(以降、この WC-7.8wt%Co 合金を Co 合金と呼ぶ)。 Fig.5 に H.P、L.P および Blend タイプの組織観察結 果を示す。



Fig.5 Optical micrographs of spark sintered WC-Ni cemented carbide prepared from (a)H.P, (b)L.P and (c)Blend type WC-Ni powder.

図から、ほぼ同様の組織を示しており、その空隙も僅 かであることが確認される。なお、バインダー相であ る Ni について、めっきおよび粉末のどちらの場合で もその添加量は20wt%としたが、実際には焼結時に、 ばりとして Ni がかなりの量しみ出しており、焼結後 に蛍光X線分析によって調査したところ、どのタイプ についても、Ni 量は約12wt%(28vol%)になっている ことを確認した。この量は、先にも述べた WC が等粒 径で最密構造をとっている場合の空隙の量(0.26)は 0.26 で、良く一致しており、十分に真密度化できてい ると判断される値である。 以上より、WC 粉末に無電解 Ni めっきを施した粉 末を用いたプロセスでは、非常に低温で液相焼結を行 い、真密度化を可能とすることが分かった。

Fig.6にNiとPの二元系平衡状態図を示す。



Fig.6 Equilibrium phase diagram of Ni and P.

図からNiとPの共晶温度が1153Kであることが分か る。H.P タイプの焼結温度が、この温度と良く一致し ており、つまり、焼結温度の低下はPの存在による融 点の低下によるものと考えられる。H.P タイプでは、 Pの重量比が13wt%、L.P タイプで 5wt%程度である が、これが mol 比で、それぞれ35%および11%程度 となる。このことから、H.P タイプでは、焼結温度が 1153K に到達した時点で完全に共晶反応を示してい たものと考えることができる。L.P タイプについては、 焼結温度から考えるとそのP量は小さいが、1273Kの 焼結温度を考慮して、共晶反応と Ni の軟化が同時に 起こることで、最終的に真密度化したのではないかと 考えることができる。

Fig.4 に示した焼結挙動について、これは Ni 中の P 量に関係していると考えられる。阿部ら⁽¹³⁾は無電解 Ni めっきについて、P 量と熱処理との関係について、 詳細な報告を行っている。無電解 Ni めっきがめっき のままで、非晶質構造であることは知られているが、 P の量が 4~5%のとき、573K から 773K の間でニッ ケルに結晶化し、P の量が 9~10%と大きくなると、 573K までで結晶化し、このときニッケルはもちろん であるが、リン化ニッケル結晶を析出するようになる と報告している。Pの量が大きくなるほど、リン化ニ ッケル結晶の析出量が増えているデータを示しており、 本研究でのP量においては、比較して、多量のリン化 ニッケルを析出しているものと考えることができる。

上記を参考にして、焼結挙動を考えてみると、まず、 H.P タイプでは、温度上昇に伴って、低温から Ni め っき相の結晶化が進み、わずかに緻密化する。焼結温 度が 800~900K になると軟化が起こり始めて、塑性 変形、塑性流動によってその緻密化速度は大きくなっ ていき、最終的に1153Kに近づくと相全体での共晶反 応で液相になって一気に緻密化が進行して、真密度化 するものと考える。L.P タイプでは、約650K で緻密 化が進んでいる部分が確認されるが、ここで、結晶化 が起こっているのではないかと考える。結晶化後は、 やはり温度上昇に伴う軟化で塑性変形によって緻密化 していき、1153Kで共晶反応とそれに伴う液相の発生 で一気に緻密化する。しかし、L.P タイプでは、その P 量が少ないために、バインダー相全体での液層化が おこらず、このため相対密度が 0.9 程度までで一度止 まる。その後、共晶で使われなかった残存の P 量で決

まる液相化温度との兼ね合いはあるが、残った固相の 更なる軟化と液相の流動で真密度化が完了するのでは ないかと考えた。

3.2 ロックウェル硬さ

Fig.7にロックウェル硬さ試験の結果を示す。





図から、本研究で作製した WC-Ni 合金の硬さは Co 合金のそれに及ばないことが分かる。ここで、WC-Ni 合金に限っては、H.P タイプが最も硬く、Ni バインダ 一相の P 量が小さくなるほど、硬さは小さくなること が分かる。

Fig.8に H.P、L.P タイプの焼結体の X 線回折結果 を示す。



Fig.8 X-ray diffraction pattern of spark sintered (a)L.P and (b)H.P type WC-Ni cemented carbide compact.

図より、L.P タイプでは WC と Ni から構成されてい ることが分かり、また、H.P タイプでは Ni の存在は 確認できるものの、主として Ni₃P と WC から構成さ れていることが確認できる。Ni₃P はリン化物であり、 その硬度は非常に高く、このため、H.P タイプの焼結 体全体としての硬さも大きくなったと考えることがで きる。また、L.P タイプについては、状態図とも照ら し合わせても Ni₃P が析出しなかったものと思われ、 微量に存在する Ni₃P は主として粒界生成物のような 形で存在しているのではないかと考える。このことか ら、粒界強度が強くなるような強化機構で、純 Ni と 比較して硬くなっているものと思われる。以上から、 試料の硬さについては、そのバインダー相の特性が強 い影響を与えることが確認された。

3.3 摩耗特性

3.3.1 比摩耗量

Fig.9 に摩耗距離(1)と摩耗減量(W)の関係を示す。 試料の種類に関係なく摩耗距離と摩耗減量の間には比



Fig.9 Relation between sliding distance and volume loss in case (a)temperless and (b)temper ring were used for wear test.

例関係が成り立つことが確認される。また、相手材料 としてのリングについて、焼き入れをして硬さが大き くしているものを用いた方がその摩耗減量が全体的に 小さくなっていることが分かる。

Wと1との間には、以下の関係が成り立つことが知られている⁽¹⁴⁾。

$$W = W_{c} Fl$$
(3)

ここで、 W_s は比摩耗量である。 Fig.9 において、F は 198N で一定であり、 W_s は直線の傾きになる。それ ぞれの得られた W_s を Table 1 に示す。

結果として、WC - Ni 合金の比摩耗量は Co 合金と 比較して、ほぼ同等かむしろ良好な結果を示した。 WC - Ni 合金のみに注目しても、H.P、L.P、Blend タイプの順に比摩耗量が小さくなっている。これは、 硬さ試験の結果とは逆の結果となっており、また、相 手材であるリングの種類(硬さ)によっても変わらなか った。つまり、バインダーである Ni 相の P 量が小さ ほど、摩耗特性は良好になる。

Table 1 Specific wear rate obtained from Fig.9. In case(a)temperless and (b)temper rings were used for wear test.

(a)	Specific wear rate (mm ² /N)	HRA
H.P	6.5×10^{-10}	85.1
L.P	5.5×10^{-10}	82.7
Blend	4.8×10^{-10}	81.0
Co alloy	7.3×10^{-10}	88.2

(b)	Specific wear rate (mm ² /N)
H.P	4.6×10^{-10}
L.P	4.1×10^{-10}
Blend	3.7×10^{-10}
Co alloy	5.1×10^{-10}

3.3.2 摩耗形態

Fig.10に H.P、L.P および Blend タイプの試験片で 摩耗試験を行った後、その摩耗痕断面について **SEM** 観察を行った結果を示す。

WC 粒子については、どの試料についても同じもの



Fig.10 SEM images of cross section at sliding surface of spark sintered (a)L.P, (b)H.P and (c)Blend type WC-Ni cemented carbide compact.

- 32 -

であり、粒子単体で考えた場合の磨耗量は同じと考え るしかない。各試験片間での摩耗量の差を考えるには、 粒子の剥離、離脱の起こりやすさが、その摩耗量に影 響を及ぼしたのではないかと考えるのが妥当であろう。 つまり、図からは定量的には判断することはできない が、恐らく特に H.P と L.P タイプを比較した場合、 H.P タイプの方で粒子の剥離、離脱が起こりやすかっ たのではないかと考える。実際、相手材料であるリン グの材質について、硬質の方が摩耗量が小さくなって いたが、これは柔らかい材質の場合、延性が高く、変 形と凝着によって WC 粒子を引きずるようになって、 剥離と離脱を促進するためではないかと考える。しか し、Blend タイプについては、むしろ粒子の剥離が起 こりやすかったのではないかとも考えられる観察結果 を示している。

ここで、バインダー相の特性について考えてみる。 Fig.11に試験片表面にビッカース圧子を打ち込んだと きのひし形圧痕頂点近傍の SEM 観察結果を示す。



Fig.11 SEM images of cracks from the corner of indent emanated by Vickers hardness test of spark sintered (a),(b)L.P, (c),(d)H.P and (e),(f)Blend type WC-Ni cemented carbide compact.

発生したクラックの長さを比較してみると、Blend、 L.P、H.P タイプの順で長くなる。 クラック長さから その破壊靱性を求めることができるが、このときクラ ック長さの-1.5 乗に比例することが知られている(1)。 L.Pタイプに比較してH.Pタイプのクラック長さは倍 以上もあり、その破壊靭性値が非常に小さくなってい ることが考えられる。クラックの進行については、L.P タイプは主としてバインダーと粒子の界面で進行して いるのに対して、H.P タイプはバインダー相と粒子の 界面はもちろん、バインダー相内も積極的に進行して いることが確認される。これより、バインダー相自体 の靭性が非常に劣ることが分かる。これは、特に硬質 である Ni₃P でバインダー相が形成されていることと も関係していると思われる。Blend タイプについては、 バインダーは純Ni であり、クラックの発生は確認さ れるものの、バインダー相には見られず、WC 粒子に 発生していることが確認された。これはつまり、摩耗 試験に置き換えた場合、粒子が割れるような状況であ っても、バインダー相は靭性を保ち、粒子剥離を抑え るように働くのではないかと思われる。L.P タイプに ついては、Ni₃Pの存在はほとんどないが、Blend タイ プと比較した場合、バインダー相へのクラックが発生 していたことを考慮して、やはり靭性は劣ると評価せ ざるを得ない。つまり、Pの存在は、バインダー相の 硬度を上げることには寄与するかもしれないが、その 靭性低下を引き起こしていると考えられる。

ここで、Fig.10 における観察結果において、Blend タイプでは、粒子剥離がむしろ積極的に起こっていた ように見られるが、これはバインダー相がリングの回 転によって摩耗面に引張られるように供給されて、 WC 粒子が僅かに浮き出るような形態を取っており、 このとき、バインダー相の靭性が高いために WC 粒子 は剥離、離脱が起こりにくく、さらに浮き出した形で の WC 粒子のみで接触するような形で、抵抗、つまり 摩擦係数(µ)を小さくするように作用したのではない かと考える。さらに、Ni で WC 粒子をコーティング するような働きもあり、WC 粒子自体の摩耗量も小さ くなったとも考えられる。実際、その摩擦係数につい て、Fig.12 に示すように、特に定常摩耗状態のときを 確認すると、H.P タイプで 0.54、L.P タイプで 0.47、





Blend タイプでは 0.43 程度となって、Blend タイプが 靭性、延性があり、凝着摩耗が起こりやすく摩擦係数 が大きくなると思われるにもかかわらず、最も小さな 値となった。なお、Co 合金については、0.61 程度と 今回行った試験対象の中では最も大きな値を示してい た。

4 結言

WC 粉末に無電解 Ni めっきを施し、この粉末を用 いて放電焼結法によって WC-Ni 合金を作製し、乾式 での摩耗試験を行い、この特性について評価した。な お、無電解 Ni めっきは、めっき中の残存 P 量の異な る2種類を行った。得られた結果は以下のとおりであ る。

 (1) 2 種類の Ni めっきについて、めっき中の残存 P 量は、約5および15%であった。本研究では、それぞ れ L.P および H.P と呼び、この粉末を用いて、放電焼 結を行った場合、その焼結温度は L.P タイプで1273K、 H.P タイプで1153K と Ni の融点 1725K から考えて 非常に低温での焼結が可能であった。これは、残存するPに関係して、その共晶反応が寄与していたためと 考えることができた。なお、焼結は液相で行った。

(2) 作製した WC-Ni 合金の硬度は、市販の粉末を用 いて作製した WC-7.8wt%Co(Co 合金)と比較して、低 い値を示した。Pの影響については、そのP量が大き くなるほど、試料硬度は大きくなった。これは、特に H.P において、析出するリン化ニッケル(Ni₃P)が影響 しているものと考えられた。L.P タイプでは Ni₃P の 析出はほとんど認められなかったが、やはり、P が Ni 中に固溶することで、その硬度を高める効果があっ たと考えられた。

(3) 作製した WC-Ni 合金の比摩耗量は、Co 合金とも 比較して、むしろ優れた摩耗特性を示した。めっき中 の P 量の影響については、P 量が大きくなるほど、比 摩耗量も大きくなった。硬さ試験と逆の結果となった が、これは、バインダー相の靭性が大きく影響してい るものと考えられた。摩耗の形態としては、どの試験 片においても、主として WC 粒子の摩耗が起こってお り、この部分についてはほとんど差がなく、比摩耗量 の差異は、WC 粒子の剥離と離脱の起こりやすさによ って決定されると考えられた。つまり、バインダー相 の靭性が低く、粒子の保持力が弱い場合には、WC 粒 子が剥離と離脱を起こしやすくなり、これによって磨 耗量は大きくなると考えた。

おわりに本研究を実施するに際して、摩耗リングの 加工等に使用した NC 旋盤および試料調整に用いた遊 星型ボールミルは、日本自転車振興会競輪機械工業資 金補助により整備したものであり、また、試料作製に 用いた放電焼結機は、経済産業省地域産業集積活性化 対策補助により整備したものであることを記し、関係 各位に深く感謝いたします。

参考文献

 H.Kim, I. Shon, J.Yoon, J.Doh and Z.Munir : Int.
J. Refract Met & Hard Mater **24**(2006) p.427-431.
S.Kursawa, P.Pott, H.G.Sockel W.Heinrich and M.Wolf : Int. J. Refract Met & Hard Mater **19**(2001) p.335-340. (3) 藤崎和弘, 落合 宏, 高田寿明, 鵜飼隆好, 但野 茂:日本機会学会北海道支部講演会概要集 41(2001) p.2-3. (4)福永 稔,町田正弘,小林慶三,尾崎公洋:粉体およ び粉末冶金 48(2001) p.616-620. (5)坂村 勝, 兼広二郎, 鈴木 寛, 藤井敬二, 水成重 順, 矢田貝稔: 広島県立東部工業技術センター研究報 告 **13**(2000) p.29-33. (6) 宮崎邦彰, 伊藤 滋, 小浦延幸, 米田 登, 浅香一 夫:粉体および粉末冶金 37(1990) p.219-224. (7) H.Sheinberg : Int. J. Refract Met & Hard Mater **2**(1983)17-26. (8) 貞廣孟史,満田哲也,高津宗吉:粉体および粉末冶 金 **29**(1982) p.222-226. (9) 松木一弘, 畑山東明, 柳沢 平:日本金属学会誌 **59**(1995) p.740-745. (10) 大森 守, 垣田 健, 平井敏雄: 日本金属学会誌 62(1998) p.986-991. (11) 松木一弘, 大澤真司, 畑山東明, 柳沢 平:日本金 属学会誌 61(1997) p.519-527. (12) 木村 博, 小林信一: 日本金属学会誌 57(1993) p.1346-1351. (13)阿部芳彦, 赤沼正信, 千葉国雄, 中尾英弘, 岩沢裕 之,川島 敏:北海道立工業試験場報告 (1992) p.43-55. (14)山本雄二、兼田楨宏:トライボロジー、理工学社、 p.189.